

附件 1

2026年淮南市“揭榜挂帅”企业需求征集表

企业名称	江苏东煦电子科技有限公司		
联系人	全金钢	职务	董秘/总经办主任
电子邮箱	tongjingang@dong-xu.com.cn	电话	18717890420
技术需求名称	面向先进封装用低应力高可靠 DAF 膜材料及工艺开发		
项目拟总投入 (万元)	1580	其中: 拟悬赏榜额 (万元)	580
技术需求情况 (简要说明)	随着集成电路封装向薄型化、高密度化和多芯片堆叠方向发展, DAF 膜 (Die Attach Film) 因具有膜厚均匀、贴装精度高、适用于薄芯片封装等优势, 已成为先进封装领域的重要关键材料。目前高性能 DAF 膜产品主要被日韩企业垄断, 国产产品在低应力设计、薄芯片适配能力、低空洞贴装及长期可靠性方面仍存在差距。现亟需开发适用于晶圆级贴装和芯片封装的 DAF 膜材料及制备工艺, 突破胶黏体系设计、膜厚精准控制及贴装工艺匹配等关键技术, 实现膜厚均匀性$\leq \pm 5\%$、吸水率$\leq 1\%$、热膨胀系数 (CTEα_1)$\leq 60\text{ppm}/^\circ\text{C}$、室温剪切强度$\geq 40\text{MPa}$、200$^\circ\text{C}$无铅回流焊 3 次后无明显开裂和分层, 满足集成电路封装领域对高可靠芯片贴装材料的应用需求, 实现关键封装材料国产化替代。		
产业类别	☐ 新能源及节能装备 ☐ PCB 电子元器件 ☐ 人工智能 ☐ 生物技术及新医药 ☐ 纤维新材料 ☒ 集成电路 ☐ 新能源汽车及零部件 ☐ 化工新材料 ☐ 绿色食品 ☐ 新		

	兴数字产业 ☐ 其他
技术需求类别	☒ 新产品研发 ☐ 产品升级换代 ☐ 生产线技术改造 ☐ 制造工艺改进 ☐ 制造装备改进 ☐ 其他
需求所处阶段	☒ 研制 ☐ 试生产 ☐ 小批量生产 ☐ 批量生产 ☐ 其他
其他	是否愿意与有类似需求的企业合作: ☒ 愿意 ☐ 不愿意

